

NUMBER 178139

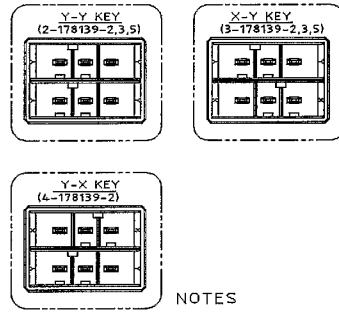
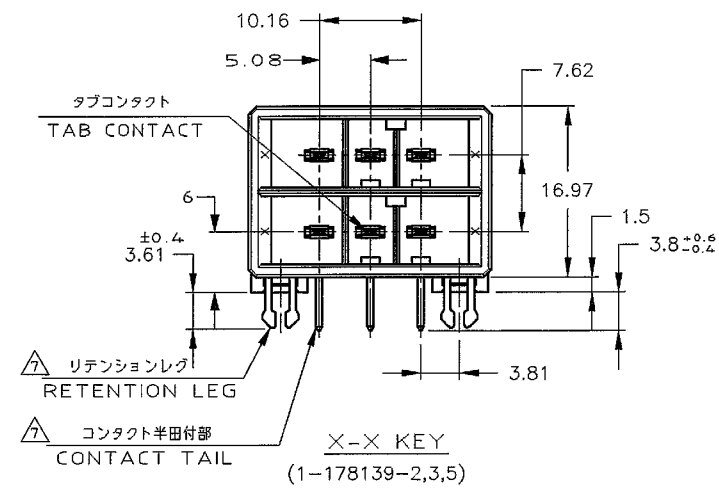
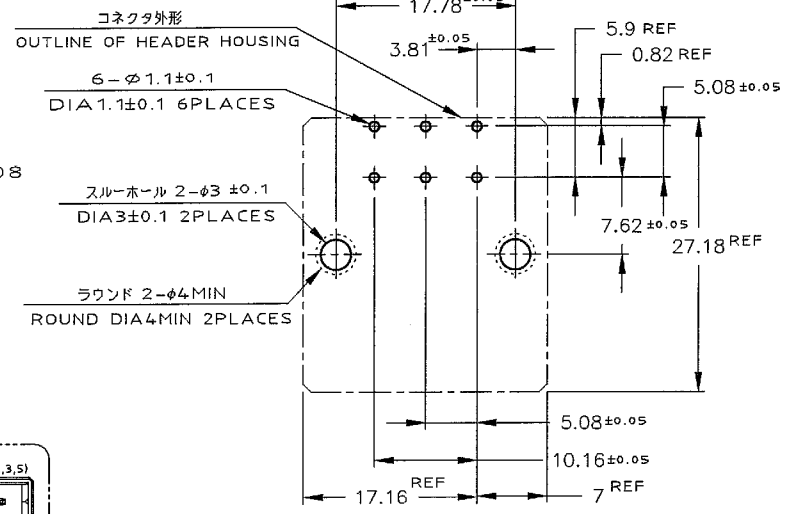
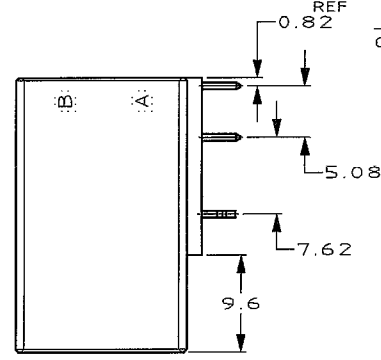
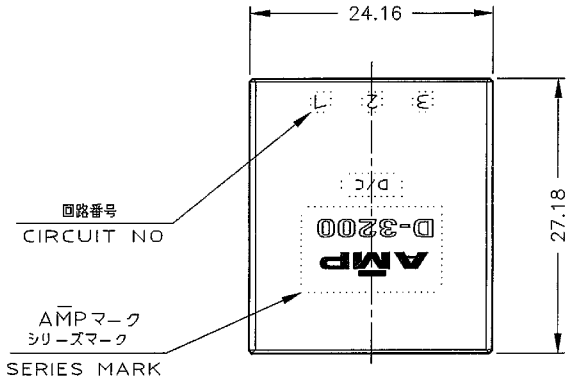
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J  
REV.10/93



推奨基板取付け穴法  
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- PRODUCT SPEC: 108-5349
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接合部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接合部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接合部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき
- 製品規格: 108-5349
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき

△	△	1,2,3-178139-5
△	△	1,2,3-178139-3
△	△	1,2,3,4-178139-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

Copyright © 1995 Tyco Electronics AMP K.K. タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社				Copyright © 1995 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.								Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
WIRE RANGE				INSULATION DIA				NAME							
mm <sup>2</sup> (AWG - )				mmφ				6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200							
MATERIAL				FINISH				SIZE				LOC			
SEE NOTE 注記参照				SEE NOTE 注記参照				A3				J			
DR. K.IKEDA				DE. K.IKEDA				NUMBER				C=178139			
CHK. S.MANABE				APP. S.MANABE				SCALE				REV. D			
SHEET				1 OF 1				SCALE				REV. D			

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面